横浜・技術職求人・Advanced Semiconductor Packaging Engineer（AIチップ関連）

技術ポジション　大手企業　雰囲気友好　女性歓迎　社保完備　交通費支給　土日祝休み

募集職種

採用企業名
株式会社iSoftStone Japan

支社・支店
株式会社ISoftStone　Japan

求人ID
1613012

部署名
技術開発部

業種
通信・キャリア

会社の種類
大手企業 (300名を超える従業員数) - 外資系企業

外国人の割合
外国人 半数

雇用形態
契約

勤務地
神奈川県, 横浜市神奈川区

給与
500万円 ~ 800万円

勤務時間
平日9：00ー18：00（休憩時間　60分）

休日・休暇
年間休日 120日以上　有給休暇 初年度 10日(6か月目~)　完全週休二日制 土 日 祝日 年末年始

更新日
2026年11月26日 09:00

応募必要条件

職務経験
1年以上

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
ビジネス会話レベル

日本語レベル
ネイティブレベル

その他言語
中国語： 北京語 - ビジネス会話レベル

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【募集概要】

AIチップおよび高性能コンピューティング（HPC）向けの先進半導体パッケージング技術の開発・評価に携わるエンジニアを募集しています。

本ポジションでは、先端パッケージング技術に関する専門知識を活かし、試作品の開発・評価、技術課題の分析・改善、日本国内のサプライヤーとの技術連携およびプロジェクト推進をご担当いただきます。

【業務内容】

1. **先端半導体パッケージング技術の開発・評価**
    - AIチップおよび高性能半導体向けパッケージング技術の開発・評価業務
    - 試作品の製作支援、性能評価、検証および技術的な問題の分析・改善
    - パッケージングプロセスに関する技術課題の抽出および改善策の検討
2. **プロジェクト推進・技術調整**
    - 社内技術チームおよび関連部門との連携・調整
    - 技術資料、プロジェクト関連資料の作成・整理
    - 開発スケジュールの管理、進捗確認および課題対応
3. **サプライヤーマネジメント**
    - 日本国内の半導体関連サプライヤーとの技術的なコミュニケーション
    - 試作・評価に関する技術調整、仕様確認および品質改善の推進
    - サプライヤーとの協力関係の構築および維持
4. **グローバル技術連携**
    - 日本および中国の技術チームとの情報共有・技術調整

日中双方の関係者との円滑なコミュニケーションによるプロジェクト推進

【勤務条件】

- 勤務地： 神奈川県横浜市
- 勤務時間： 9:00 ~ 18:00（休憩60分）
- 休日・休暇： 完全週休2日制（土日）、祝日
- 給与： 経験・スキル・能力を考慮のうえ、応相談

【ポジションの魅力】

- 最先端のAI半導体技術に携われる環境： AIチップやHPC向け半導体の進化を支える先端パッケージング技術に携わることができます。
- 専門性を高められるポジション： 高密度実装、異種チップ集積など、次世代半導体技術に関連する専門性を深める機会があります。
- グローバルな開発環境： 日本・中国の技術チームやサプライヤーと連携し、国際的なプロジェクト推進に貢献できます。

スキル・資格

【必須条件】
・水素エネルギー業界での経験
・セラミック材料パッケージング、金属溶接等の分野における経験
・SOEC、RSOC等の電解槽について、動作原理、構造設計、重要材料、製造プロセスおよび組立プロセス等を理解できる方

【歓迎条件・人物像】
・業務に柔軟に取り組める方

・実験手順を遵守できる方
・積極性、責任感、コミュニケーション能力をお持ちの方

会社説明